DOCU	JMENT №. KRN-701	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 1/6
	DUCT No. NPAE010	For reference 参考	Date:.201707
1.1 A 1.2 C 1.3 S	neral 一般事項 Application 適用範囲 Operating temperature rar Storage temperature rang Test conditions 試験状態	この規格書は、キートップなしのタクトスイッチについて 適用する。 nge 使用温度範囲: <u>-40</u> ~ <u>90</u> ℃ (normal humidity,normal air pressure 常湿・常) e 保存温度範囲: <u>-40</u> ~ <u>90</u> ℃ (normal humidity,normal air pressure 常湿・常	圧) tests are as follows.
2.1 A	pearance, style and dime Appearance 外観 Style and dimensions 形	There shall be no defects that affect the serviceability of the pro 性能上有害な欠陥があってはならない。	oduct.
3. Тур	pe of actuating 動作形式	式 <u>Tactile feedback</u> タクティールフィードバック	
4. Coi	ntact arrangement 回路		羊細は製品図による)
5.1 N	tings 定格 Maximum ratings 最大定 Minimum ratings 最小定核		
6. Ele	ctrical specification 電気	司的性能	
	接 触 抵 抗 r ;	Test conditions 試験条件 Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be nade. A(ッチ操作部中央に下記の静荷重を加え,測定する。 (1) Depression 押圧力: First action	<u>Criteria</u> 判定基準 First action: <u>100 m</u> Ω Max. Second action: <u>100 m</u> Ω Max.
	resistance ⁻ 絶 縁 抵 抗	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後, 測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: <u>100</u> V DC for 1 min. (2) Applied position 印加場所:Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間, 金属フレームがある場合は, 端子と 金属フレーム間	<u>100 Μ</u> Ω Min.
6.3	耐電圧	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: <u>250</u> V AC (50~60Hz) (2) Duration 印加時間:1 min (3) Applied position 印加場所:Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間,金属フレームがある場合は、端子と 金属フレーム間	There shall be no breakdown. 絶縁破壊のないこと。
	ELECTRIC CO.,LTD.		

DOCI	JMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
	KRN-701	製品仕様書	2⁄6
	DUCT No. NPAE010	For reference 参考	Date:.2017
	Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
6.4	Bounce バウンス	Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations per s), bounce shall be tested at "ON" and "OFF". スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し, ON時及び OFF時のバウンスを測定する。	First,Second action: ON bounce : <u>10</u> ms Max OFF bounce: <u>10</u> ms Max.
		$ \begin{array}{c c} & & & & \\ & & & &$	
		$ \begin{array}{c c} & & \\ & \\ & \\ & \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$	
7. IVIE	echanical specification		
7.1	Items 項 目 Operating force 作 動 力	Test conditions試験条件Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increasing the load applied to the center of the stem, the maximum load required for the switch to come to a make "ON" shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し,操作部中央部に徐々に荷重を 加え,スイッチがONするまでの最大荷重を測定する。	Criteria 判定基準 First action <u>0.78</u> ± <u>0.39</u> N Second action: <u>2.45</u> ± <u>0.59</u> N
7.2	Travel 移 動 量	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying a static load of bellow force to the center of the stem, the travel distance for the switch to come to a make "ON" shall be measured.	First action : 0.25 ± 0.1 mm Second action: 0.4 ± 0.15 mm
7.3		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し,操作部中央部に静荷重を加え, スイッチがONするまでの距離を測定する。	
	Return force 復 帰 力	スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し,操作部中央部に静荷重を加え,	First action : <u>0.1</u> N Min. Second action: <u>0.78</u> N Min.
		 スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し,操作部中央部に静荷重を加え, スイッチがONするまでの距離を測定する。 The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and,upon depression of the stem in its center the whole travel distance ,the force of the stem to return tot its free position shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し,操作部中央部を全移動量押圧 	
7.4	復 帰 力 Stop strength	 スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し,操作部中央部に静荷重を加え, スイッチがONするまでの距離を測定する。 The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and,upon depression of the stem in its center the whole travel distance ,the force of the stem to return tot its free position shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し,操作部中央部を全移動量押圧 後,操作部が復帰する力を測定する。 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below static load shall be applied in the direction of stem operation. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し,スイッチの操作方向へ以下の 静荷重を加える。 (1) Depression 押圧力: 29.4 N (2) Time 時間: 60 s 	Second action: <u>0.78</u> N Min. There shall be no sign of damage mechanically and electrically.
7.4	復 帰 力 Stop strength ストッパー強度	 スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し,操作部中央部に静荷重を加え, スイッチがONするまでの距離を測定する。 The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and,upon depression of the stem in its center the whole travel distance ,the force of the stem to return tot its free position shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し,操作部中央部を全移動量押圧 後,操作部が復帰する力を測定する。 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below static load shall be applied in the direction of stem operation. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し,スイッチの操作方向へ以下の 静荷重を加える。 (1) Depression 押圧力: 29.4 N (2) Time 時間: 60 s 	Second action: <u>0.78</u> N Min. There shall be no sign of damage mechanically and electrically.

	(3)Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	
.2 Heat resistance 耐熱性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後,常温,常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: <u>90</u> ± <u>2</u> ℃ (2) Time 時間: <u>96</u> h	Item 6. Item 7.1 Item 7.2
.3 Moisture resistance 耐湿性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後,常温,常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: <u>60</u> ± <u>2</u> °C (2) Time 時間: <u>96</u> h (3) Relative humidity 相対湿度: <u>90</u> ~ <u>95</u> % (4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1): <u>500 m</u> Ω Max. Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 6.2): <u>10</u> M Ω Min. Item 6.3 Item 6.4 Item 7.1 Item 7.2

DOCI	JMENT №. KRN-701	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書		PAGE 3⁄6
PRODUCT No. SKRNPAE010				Date:.20170
		For reference 参考		
8.4	Items 項 目 Change of	Test conditions 試験条件 After below cycles of following conditions, the switch shall be allowed	Criteria Item 6.	判 定 基 準
	temperature 温度サイクル	to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made. Water drops shall be removed. Tal&件で以下回数のサイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し測定する。 ただし、水滴は取り除く。 A A A A A C D E E f L C D E F C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Item 7.1 Item 7.2	
9. En	durance specification			
9.1	Items 項 目 Operating life 動 作 寿 命	Test conditions 試験条件 Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) 5_VDC 5_mA resistive load 抵抗負荷 (2) Rate of operation 動作速度: 2_to_3_operations per s 回/秒 (3) Depression 押圧力: 30,000 cycles of operation 動作回数:	<u>500 m</u> Ω Max.	_ms Max. _ms Max. 動力(Item 7.1):
9.2	Vibration resistance 耐振性	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1)Vibration frequency range 振動数範囲: 10 ~ 55 Hz (2)Total amplitude 全振幅: 1.5 mm (3)Sweep ratio 掃引の割合: 10-55-10 Hz Approx. 1 min 約 1 分 (4)Method of changing the sweep vibration frequency: Logarithmic or uniform 掃引振動数の変化方法 対数又は一様掃引 (5)Direction of vibration: Three mutually perpendicular directions, including 振動の方向 the direction of the travel スイッチ操作方向を中心とした垂直3方向 (6)Duration 振動時間: 2 h each (6 h in total)	Item 6.1 Item 7.1 Item 7.2	
9.3	Shock 耐衝撃性	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1)Acceleration 加速度: <u>784 m/s²</u> [<u>80 G</u>] (2)Acting time 作用時間: <u>11 msec</u> (3)Test direction 試験方向: 6 directions 6 面 (4)Number of shocks 試験回数: <u>3</u> times per direction (<u>18</u> times in total) 各方向各 <u>3</u> 回(計 <u>18</u> 回)	Item 6.1 Item 7.1 Item 7.2	

	MENT №. KRN—701	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 4∕6		
			Date:.20170		
	UCT №. NPAE010	For reference 参考			
0. Solo	dering conditions 半1				
	Items 項 目	Recommended conditions 推			
10.1	Hand soldering	Please practice according to below conditions.			
	手 半 田	以下の条件にて実施して下さい。			
		(1)Soldering temperature 半田温度: <u>350</u> °C Max.			
		(2)Continuous soldering time 連続半田時間: <u>3</u> s Max. (3)Capacity of soldering iron 半田コテ容量: <u>60</u> W Max.			
		(4)Excessive pressure shall not be applied to the terminal.			
		端子に異常加圧のないこと			
10.2					
	リフロー半田 以下の条件にて実施して下さい。				
		(1)Profile 温度プロファイル			
		Surface of product Temperature 部品表面温度(℃)			
		260 °C Max3 s Peak Temperature t°			
			7.血皮		
		180			
		150			
		Time 時間			
		$ \underbrace{120 \text{ Max}} \underbrace{40 \text{ s Max}} $			
		(Pre-heating 予熱)			
		_3 ~ _4 _min. Max.			
		← Time inside soldering equipment 炉内通過時間			
		(2)Allowable soldering time 半田回数: <u>2</u> time Max.			
		(The temperature shall go down to a normal temperature in prior to exposure to the second time : 2回目を行う場合には、スイッチが常温に戻ってから行うこと。)			
10.3	Other precautions	(1)Switch terminals and PCB. Upper face shall be free from flax prior to soldering.			
	For soldering	事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。			
	半田付けに関する	する (2)Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like.			
	その他注意事項				
		(3) Recommended cream solder : M705-GRN360-K2(SENJU METAL INDUSTRY CO.,LTD) or equivalent 推振力リーム光田・工住全屋工業(株) M705-CRN260-K2、同等日			
		推奨クリーム半田:千住金属工業(株) M705-GRN360-K2 同等品 (4) When chin components is soldered on the back side of PCB by automatic flow soldering after this switch soldered by reflow soldering			
		(4) When chip components is soldered on the back side of PCB by automatic flow soldering, after this switch soldered by reflow soldering, flux will possibly creep up at the exterior wall of the housing and penetrate into the housing due to flux ejection. Therefore, when the PCB is			
		flux will possibly creep up at the exterior wall of the housing and penetrate into the housing due to flux ejection. Therefore, when the PCB is designed, please do not locate through holes adjacent to the switch mounted area.			
		本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等	によりスイッチ側面から		
		フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたってはスイッチ下面、周囲にスルーホールを設けなし			
		(5) As the conditions vary somehow depending on the kind of reflow soldering equipment, please make sure you have t			
		リフロー槽の種類により、多少条件が異なりますので、事前に十分確認の上使用してください。			
		(6)As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be performed in the short	est period and at the		



DOCUMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
KRN-701	製品仕様書	5⁄6
PRODUCT No.		Date:.201707
SKRNPAE010	For reference 参考	
and communication devices. In space & aviation devices, disa 本製品はオーディオ機器, 映像機器 高度な安全性や信頼性が求めら A2. This product is designed and or capacitive (C)), please let	ned and manufacturfd for general electronic devices, such as audio devices, visual devices, home electronics, n case this product is used for more sophisticated equipment requiring higher safety and reliability, such as li aster prevention & security system, please make verification of comformity or check on us for the details. 景,家電機器,情報機器,通信機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。生命維持装置,宇宙・航空機器 かれる用途に使用される場合は,貴社にて適合性の確認を頂くか,当社へご確認ください。	fe support system, , 防災・防犯機器などの of resistance (inductive (L)
B1. Note that if the load is appl 端子をはんだ付けされる場合	C board process 半田付,基板実装工程 ied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。 be confirmed under actual production conditions.	
はんだ付けの条件の設定につ	かいては、実際の量産条件で確認されるようお願いします。	
automatic dip soldering after	gned for reflow soldering, if you place it at the edge of PCB for convenience, then flux may get into the sli ^r being mounted, so do not apply auto dip after being mounted. 日対応ですが, スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが浸入する恐れが	
-	orate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be done within the recommended conditions. 「低下する可能性がありますので推奨リフロー条件以内でリフローを行う様にお願いします。	
C. Washing process 洗浄工程 C1. Following the soldering proce 半田付け後, 溶剤等でスイッラ	ess, do not try to clean the switch with a solvent or the like. Fを洗浄しないでください。	
	ut) 機構設計 nd pattern for mounting a printed circuit board shall refer to the recommended dimensions in the engineering ーンは, 製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。	drawings.
on the wall of the housing a 本スイッチをリフロー半田後,	nponents on the backside of PCB after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cau and penetrate the switch. Therefore, do not design a throughhole under and around the switch. プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は, ディップ時のフラックス吹き上げ等により, スイッチ側面より, フラ こあたっては, スイッチ下面, 周囲にスルーホールを設けないで下さい。	
	ty on the scaling film of the switch. なもので押さえることは避けて下さい。	
_	n is required, please consult with our detector switch section. 介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。 は、避けてください。	
(Refer to the strength of th	you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than spece e stopper.) pplied to the area, which is out of actuator, this may also cause the similar damage or breakage to the swit	
Enough care shall be taken	pplied to the area, which is out of actuator, this may also cause the similar damage of breakage to the swit to assure that stress is properly applied to actuator. 荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。	итт.
	作範囲外であった場合にも、同様にスイッチの破損が考えられますので、操作範囲外には荷重を加えないで下さい。	
D6. Shape of keying tip: 打鍵部分 •It is recommended that the	先端形状 e tip of the keuing section be SR3(ϕ 1.2)	

右図に示す Ø1.2mm先端SR3の形状を推奨いたします。



DOCUMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
KRN-701	製品仕様書	6/6
PRODUCT No.		Date:.201707
SKRNPAE010	For reference 参考	
_	▶ F条件 yeen the center of the switch and the center of keying section is 0.5mm(max). ■心軸線から打鍵部中心軸線間のセンターズレは0.5mm以下にて御使用下さい。	
	e atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause 可能性がある環境では, 端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用になら	-
However, it is recommended	immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor cor that you should use it as soon as possible before six months pass. 常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来る	
You should use it up as soo	u should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the sam on as possible. D遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。	ne environment mentioned above.
F3. Do not stack too many swite 過剰な積み重ねは行わないで		
-	alid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. を経過して, ご返却又はご発注の無い場合は, 無効とさせていただきます。	
	specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be cha 法および取付寸法以外につきましては, 当社の都合により変更させて頂く事が有りますので, あらかじめ御	-
you must take certain prote	nd the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due t ctive measures, such as a protective circuit to shut down the current. 生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護[
can catch fire, or take meas	e plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refra sures to preclude catching fire. の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。つきましては類焼の恐れ をお願いします。	
for a product requiring highe And secure safety as a who スイッチの品質には万全を尽く	switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. The r safety level, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in c le system by introducing the fail-safe design, i.e. a protection network. (していますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの 設計いただき、保護回路、等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようにお願	ase the switch alone should fail. 設計に際しては、SWの単品故障に対して